

## C-211B银导体浆料

### 概述:

C-211B 是一款无卤环保型有机聚合物银导体浆料，用于片式元件低温银端头。产品固化膜可镀性好，附着力强，导电性好，耐酸及耐溶剂性好，可靠性高。固化膜硬度及韧性适中，适用浸涂工艺和涂刷工艺。

### 主要技术指标:

项 目	测试方法	技术指标
色 态	目测	银灰色、均匀浆状
粘 度 (Pa·s)	BROOKFIELD SC4-14 10RPM, 25℃	80±20
方 阻 (mΩ/□)	印刷图形0.6mm×60mm, 测固化膜电阻	≤60
附着力	百格刀刻划后, 3M #600胶带剥离测试	良好 (100/100 )
潮湿试验阻值变化率 (%)	+85℃, 85%RH, 250Hr	≤+15%
恒温存放阻值变化率 (%)	+60℃, 500Hr	≤+15%
热循环试验阻值变化率 (%)	-20~+40℃、10 cycles	≤+10%

### 推荐工艺与使用说明:

印刷丝网: 200目不锈钢丝网、乳胶厚度 10~15 μm,

印刷刮板: 聚氨酯刮板, 硬度60~80 ,

干燥条件: 100~150℃, 10 min

固化条件: 180℃-30 min (固化条件可依据用户使用具体条件和需求适当调整)

固化膜厚: 10- 15 μm

粘度调整: 最好使用专用稀释剂稀释, 用量不超过1%。

储存条件: 贮藏于5-10℃冷藏柜中, 保质期6个月。

使用建议: 浆料未开封条件下充分回温, 印刷前用刮刀搅拌均匀;

产品使用场地洁净、通风良好。